

S3088 *ultra chrome* | SPI

最高检测质量的高效 3D 锡膏检测

S3088 *ultra chrome* 3D 锡膏检测为最大化实现 SMT 制造的经济效益提供了显著的优势。其主要的特征包括 90 cm²/s 的检测速度以及 58,2 mm x 58,2 mm 的相场尺寸。直角光学分辨率为 10 μm, 并与 4 个斜角视图一起提供了完美、无阴影的检测结果, 这对极小的检测区域来说至关重要。选配的 Viscom FastFlow 处理功能可极大的提高效率。高速地实现同步导入和导出组件。

该检测系统经过成本效益的完美配置, 以 Viscom 独一无二且成熟的 XM 相机技术为基础, 将精确的缺陷识别与最高速的检测融为一体。S3088 *ultra chrome* 能检测印刷电路板锡膏的所有质量标准, 例如体积、形状、面积、高度、位移、锡桥和涂抹。

通过评估 3D 测量数据以及通过 Quality Uplink 将评估结果与 锡膏印刷、自动贴片机、AOI 和 AXI 链接, 可实现高效的工艺控制和可持续化的质量优化。Viscom 的 3D SPI 系统能借此提示工艺薄弱环节, 并能自动调整, 例如调整筛网清洁周期或修正印刷错误或贴片偏移。

通过 FastFlow 处理功能
实现极高效率

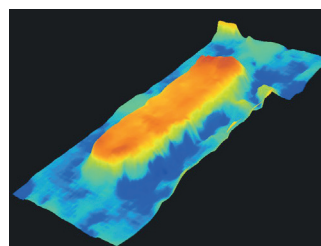
改进的检测质量和检测速度

4 个斜角视图实现
无阴影的检测图像

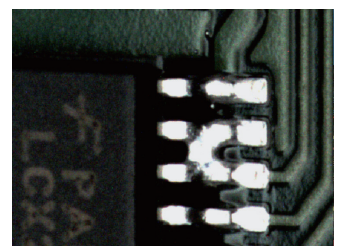
可重复性高

操作极其简便: 用于验证的彩色图像高效的检测程序创建

Viscom Quality Uplink
实现最佳直通率结果



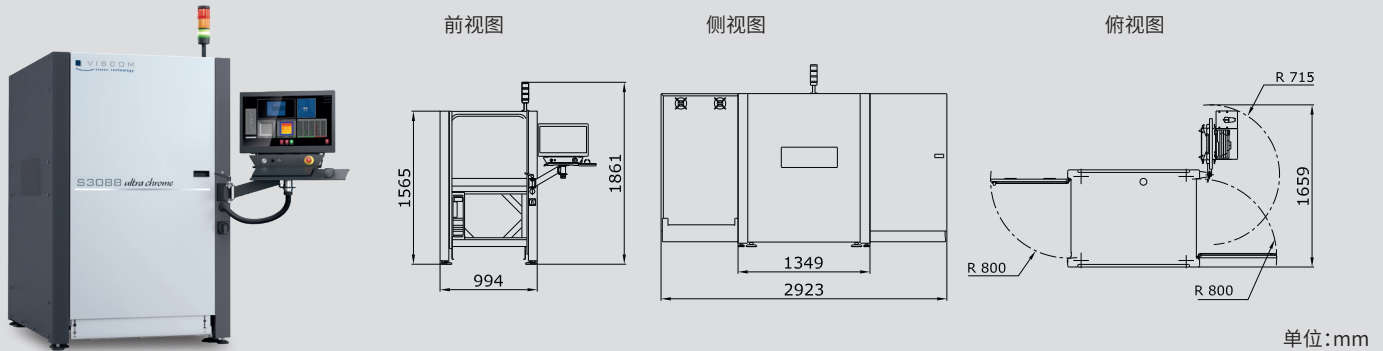
色彩的 3D 锡膏体积确



焊接后的焊锡连桥

3D SPI

技术数据



S3088 ultra chrome SPI		
检测范围	3D SPI	检查锡膏分配 (钢网模板印刷或点胶技术, 板尺寸精确至 01005 元件), 也可检查银烧结膏。检查是否存在、面积、高度、印刷错位 (X/Y 位移)、涂抹, 并可选配检查: 形状、共面度、空白面积分析、OCR、DCM
相机系统	3D 传感系统	
	测量方法	条带投影法
	Z 分辨率	0.1 μm
	斜角相机	
	百万像素摄像头数量	4
	正交相机	
性能数据	分辨率	10 μm 高解析度, 20 μm 标准
	像场尺寸	58,2 mm x 58,2 mm
性能数据	高度测量重复精确度	2 μm (对校准治具, 高度 $\ll 10\%$ @ 6 σ (对校准治具))
	锡膏高度	最大 4000 μm
软件	操作界面	Viscom EasyPro/vVision
	统计进程控制	Viscom SPC, 开放式接口 (选配)
	验证维修站	Viscom HARAN/vVerify
	远程诊断	Viscom SRC (软件远程控制) (选配)
	编程站	Viscom PST34 (选配)
系统计算机	操作系统	Windows®
	处理器	Intel® Core™ i7
印刷电路板处理	输送方案	单轨输送, 双轨输送, (双轨输送, 系统型号 S3088 DT)
	印刷电路板尺寸 (长 x 宽)	508 mm x 508 mm, 可提供长板选项
	传送高度	850 - 950 mm $\pm$ 20 mm
	宽度调整	自动
	印刷电路板夹紧装置	气动
	上方净空尺寸 (最大)	50 mm
	下方净空尺寸	45 mm, 选配可达 85 mm (含PCB支架40 mm)
检测速度		最高可达 90 cm ² /s
其他系统数据	行走/定位单元	同步线性马达
	接口	SMEMA (其他接口请具体咨询)
	电源要求	400 V (其他电压请具体咨询), 3P/N/PE, 8 A, 工作压力 4 - 6 bar
	系统尺寸	994 mm x 1565 mm x 1349 mm (宽 x 高 x 长)
	重量	720 kg